

英飞凌IM69D127V11

IP57 防尘防水 PDM 数字 XENSIV™ MEMS 麦克风

描述

IM69D127V11 是一款超高性能数字 PDM MEMS 麦克风，专为需要极高 SNR（低自噪声）和低失真（高 AOP）的应用而设计，并且具有 IP57 防尘防水等级。

69dB(A) 的最佳信噪比 (SNR) 可实现远场和低音量音频拾取。平坦的频率响应（40Hz 低频滚降）和严格的制造公差提高了多麦克风（阵列）应用的性能。

数字麦克风 ASIC 包含一个极低噪声前置放大器和一个高性能 sigma-delta ADC。可以选择不同的电源模式以适应特定的时钟频率和电流消耗要求。

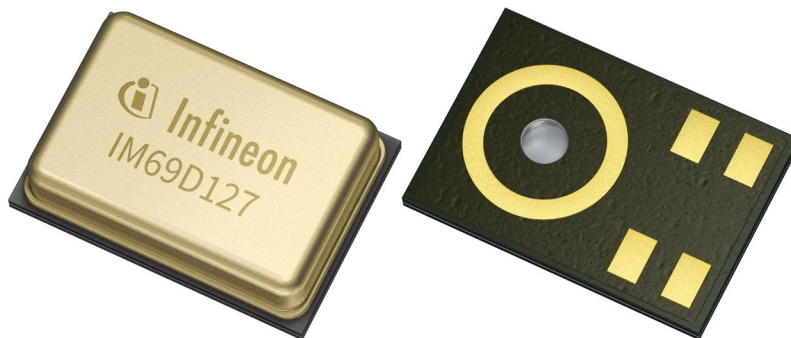
每个 IM69D127V11 麦克风均采用先进的英飞凌校准算法进行校准，从而实现较低的灵敏度公差（±1dB）。

特性

- 组件等级 IP57 防尘防水
- 动态范围102dB
 - 信噪比为 69dB(A) SNR
 - 总谐波失真 <1%，最高可达 123dBSPL
 - 声过载点 (AOP) 为 127dBSPL
- 精确的灵敏度匹配（± 1dB），适用于波束成形应用
- 平坦的频率响应，低频截止频率 (LFRO) 为 40Hz
- 由 PDM 时钟频率决定的功率优化模式
- 封装尺寸：3.60mm x 2.50mm x 1.00mm
- PDM输出
- 全向拾音模式

典型应用

- 主动降噪 (ANC) 头戴式和入耳式耳机
- 具有语音用户界面 (VUI) 的设备
 - 智能音箱
 - 智能家居
 - 物联网设备
- 高品质音频采集
 - 相机
 - 笔记本电脑和平板电脑
 - 会议系统



本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 infineon.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

框图

框图

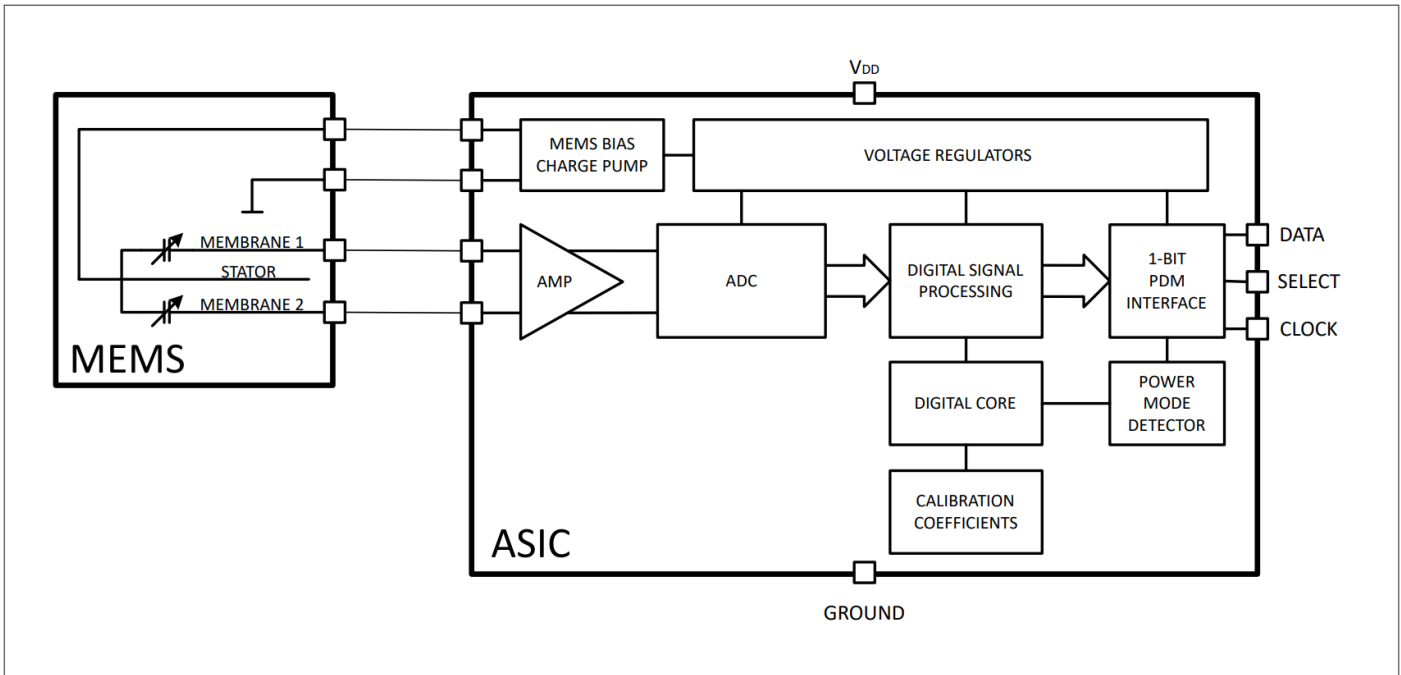


图 1 IM69D127V11 框图。

产品验证

符合工业应用的技术。

通过 IEC 60747 和 60749 或 JEDEC47/20/22 的相关测试，符合工业应用的验证标准。

环境稳健性

英飞凌最新的密封双膜 MEMS 技术实现了麦克风级别的高等级防护 (IP57)。密封的 MEMS 设计可防止水或灰尘进入膜片和背板之间，从而防止 MEMS 麦克风中常见的机械阻塞或电流泄漏问题。采用密封双膜技术制造的麦克风仅需要简单的防护即可用于 IP68 的产品中。

表 1 环境稳健性

Test Standard	Test Condition
IP5x dust resistance ¹⁾	Arizona dust A4 coarse, vertical orientation , sound hole upwards, 10 cycles (15 minutes sedimentation, 6 sec blowing)
IPx7 water immersion ²⁾	Temporary immersion of 1 meters for 30 minutes. Microphone tested 2 hours after removal

¹ 数字“5”代表防尘等级或抵抗细小磨蚀性灰尘颗粒影响的能力。

² “7”代表更高的防水等级。

目录

目录

	描述	1
	特性	1
	典型应用	1
	框图	2
	产品验证	2
	环境稳健性	2
	目录	3
1	典型性能特性	4
2	声学特性	5
2.1	自由场频率响应	6
3	电气参数及特性	7
3.1	绝对最大额定值	7
3.2	电气参数	7
3.3	电气特性	8
3.4	数字接口时序规格	9
3.5	PDM 通道配置	9
3.6	音频DC偏置	9
3.7	立体声 PDM 操作	10
4	封装信息	11
5	焊盘和钢网模版推荐	12
6	包装信息	13
7	回流焊和电路板组装	14
8	可靠性规格	16
	修订记录	17
	词汇表	17
	免责声明	18

典型性能特性

1 典型性能特性

测试条件: $V_{DD}=1.8V$, $f_{CLK}=3.072MHz$, DATA 上无负载

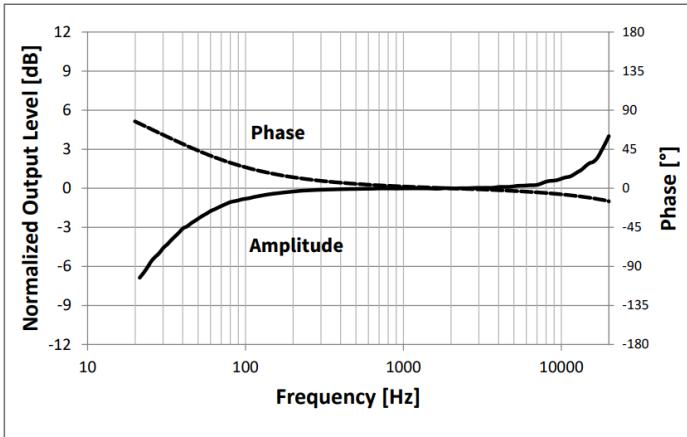


图 2 典型振幅和相位响应

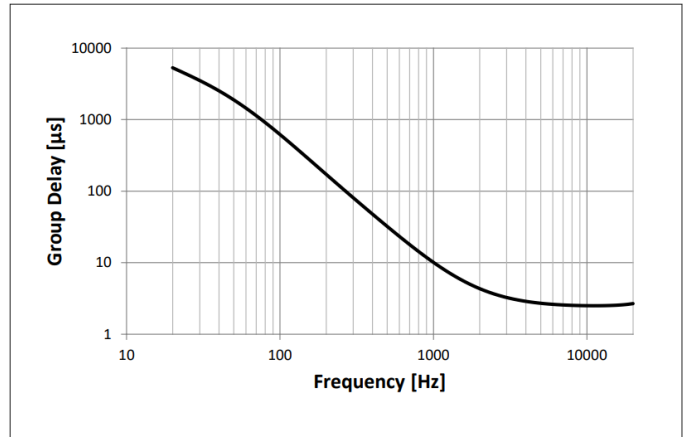


图 3 典型群延迟与频率的关系

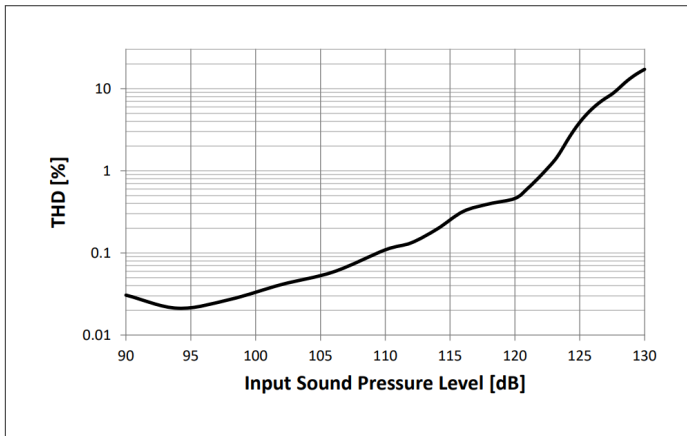


图 4 典型 THD 与 SPL

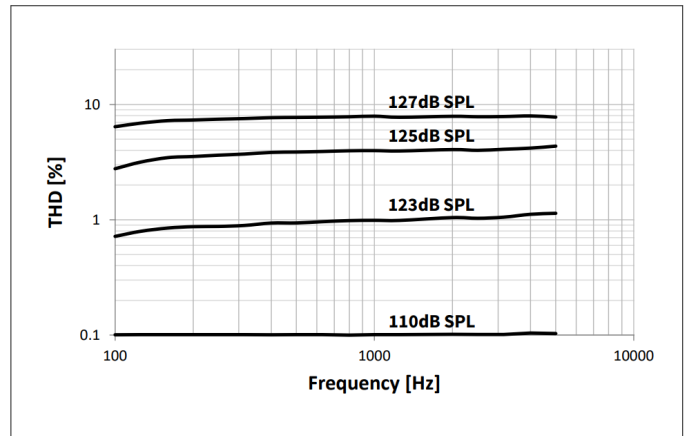


图 5 典型 THD 与频率的关系

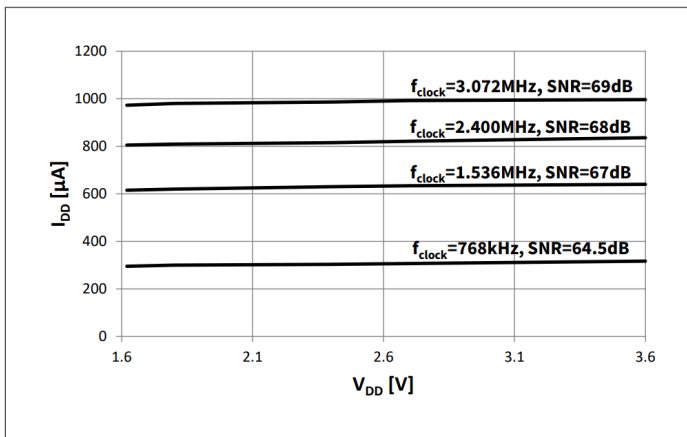


图 6 典型 I_{DD} 与 V_{DD}

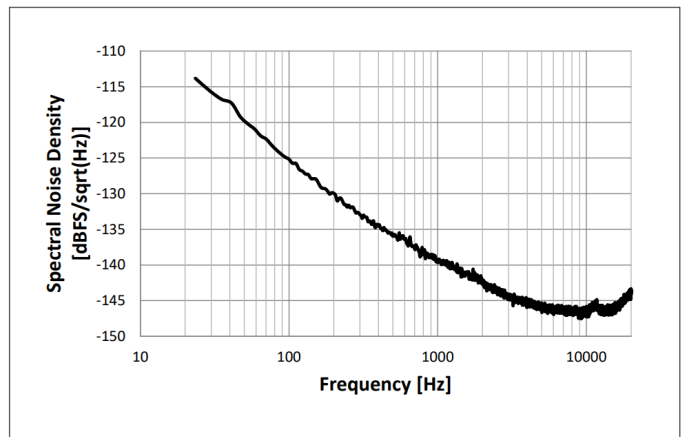


图 7 典型的本底噪声 (未加权)

声学特性

2 声学特性

测试条件（除非表中另有说明）： $V_{DD} = 1.8V$ 、 $f_{CLK} = 3.072MHz$ 、 $T_A = 25^\circ C$ 、55% R.H.、音频带宽 20Hz 至 20kHz、Select 引脚接地、无负载、 $T_{edge} = 9ns$

表 2 IM69D127V11 声学规格

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note or Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Sensitivity		-35	-34	-33	dBFS	1kHz, 94dB SPL, all operating modes
Acoustic overload point	AOP		127		dB SPL	THD = 10%, all operating modes
Signal to Noise ratio	$f_{clock}=3.072MHz$	SNR		69	dB (A)	A-Weighted 20Hz to 8kHz bandwidth, A-Weighted;
	$f_{clock}=2.4MHz$			68		
	$f_{clock}=1.536MHz$			67		
	$f_{clock}=768kHz$			65		
Total harmonic distortion	94dB SPL	THD		0.5	%	Measuring 2nd to 5th harmonics; 1kHz. All power modes
	123dB SPL			1		
	127dB SPL			10		
Low frequency cutoff point		f_{CLP}		40	Hz	-3dB point relative to 1kHz
Group delay	250Hz			113	μs	
	600Hz			23		
	1kHz			9		
	4kHz			3		
Phase response	75Hz			30	°	
	1kHz			2		
	3kHz			-2		
Directivity			Omnidirectional			Pickup pattern
Polarity			Positive pressure increases density of 1's, negative pressure decreases density of 1's in data output.			

声学特性

2.1 自由场频率响应

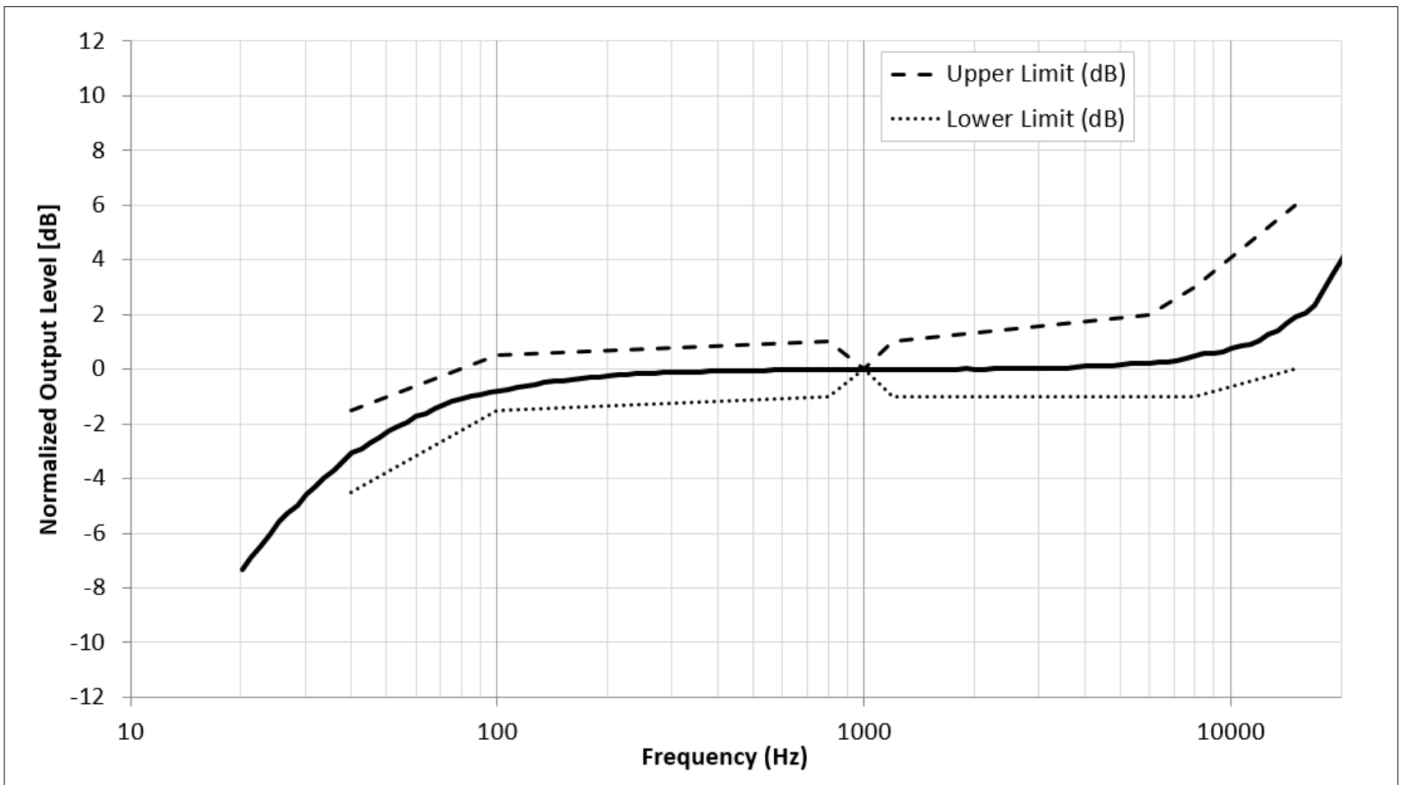


图8 IM69D127V11 自由场频率响应

表 3 IM69D127V11 自由场频率响应，标准化为 1kHz 灵敏度值。

Frequency (Hz)	Upper Limit (dB)	Lower Limit (dB)
40	-1.5	-4.5
100	+0.5	-1.5
800	+1	-1
1000	0	0
1200	+1	-1
6000	+2	-1
8000	+3	-1
15000	+6	0

电气参数及特性

3 电气参数及特性

3.1 绝对最大额定值

超过所列最大额定值运行器件可能会影响器件可靠性或导致器件永久性损坏。在这些条件下，无法保证器件正常运行。

表 4 绝对最大额定值

Parameter	Symbol	Values		Unit	Note / Test Condition
		Min.	Max.		
Voltage on any pin	V_{max}		4	V	
Storage temperature	T_S	-40	100	°C	
Operating temperature	T_A	-40	85	°C	

3.2 电气参数

表 5 电气参数和数字接口输入

Parameter		Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
			Min.	Typ.	Max.		
Supply voltage		V_{DD}	1.65	1.8	3.6	V	A 100nF bypass capacitor should be placed close to the microphone's VDD pin to ensure best SNR performance
Clock frequency range	Operating modes	f_{clock}	2.9	3.072	3.3	MHz	Intermediate frequencies between those listed cannot be used
			2.2	2.4	2.6		
			1.38	1.536	1.7		
	450	768	850	kHz			
Standby mode			250		DATA = high-Z		
V_{DD} ramp-up time				50	ms	Time until $V_{DD} \geq V_{DD_min}$	
Clock duty cycle			40		60	%	At PDM clock frequency range from minimum to typical value
			45		55		At PDM clock frequency range from typical to maximum value
Clock rise/fall time		t_{CR}, t_{CF}		13	ns		
Input logic low level		V_{IL}	-0.3		$0.35 \times V_{DD}$	V	
Input logic high level		V_{IH}	$0.65 \times V_{DD}$		$V_{DD} + 0.3$	V	
Output load capacitance on DATA		C_{load}			200	pF	

电气参数及特性

3.3 电气特性

测试条件（除非表中另有说明）： $V_{DD} = 1.8V$ ， $T_A = 25^\circ C$ ，55% R.H。

表 6 电气基本特性

Parameter		Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition	
			Min.	Typ.	Max.			
Current consumption	$f_{clock}=3.072MHz$	I_{DD}		980	1200	μA	Output load <5pF	
	$f_{clock}=2.4MHz$			800	950			
	$f_{clock}=1.536MHz$			620	740			
	$f_{clock}=768kHz$			300	350			
	Standby mode	$I_{standby}$			50			
	Clock Off mode	I_{clock_off}			10			CLOCK pulled low
Short circuit current			1		20	mA	Grounded DATA pin	
Power supply rejection		PSR			-75	dBFS	$V_{DD}=1.8V+100mV_{pp}$ sine wave, $f=40Hz$ to $100Hz$	
					-80		$V_{DD}=1.8V+100mV_{pp}$ sine wave, $f=100Hz$ to $20kHz$	
Startup time	$\pm 0.5dB$ sensitivity accuracy				20	ms	Time to start up in all operating modes after V_{DD_min} and CLOCK have been applied	
	$\pm 0.2dB$ sensitivity accuracy				50			
Mode switch time	$\pm 0.5dB$ sensitivity accuracy				20	ms	Time to switch between operating modes. V_{DD} remains on during the mode switch	
	$\pm 0.2dB$ sensitivity accuracy				50			
Hysteresis width		V_{hys}	$0.1 \times V_{DD}$			V		
Output logic low level		V_{OL}			$0.3 \times V_{DD}$	V	$I_{out}=2mA$	
Output logic high level		V_{OH}	$0.7 \times V_{DD}$				$I_{out}=2mA$	
Delay time for DATA driven		t_{DD}	40		80	ns	Delay time from CLOCK edge ($0.5 \times V_{DD}$) to DATA driven	
Delay time for DATA high-Z ³⁾		t_{HZ}	5		30	ns	Delay time from CLOCK edge ($0.5 \times V_{DD}$) to DATA high impedance state	
Delay time for DATA valid ⁴⁾		t_{DV}			100	ns	Delay time from CLOCK edge ($0.5 \times V_{DD}$) to DATA valid ($<0.3 \times V_{DD}$ or $>0.7 \times V_{DD}$). Load on data: $C_{load}=100pF$, $R_{load}=100k\Omega$	
Power-on behavior		Idle tone is output over PDM within 3ms of applying VDD and CLK, remains until a valid microphone signal is available. Idle tones consists of alternating 1s and 0s, representing a zero input signal.						

³⁾ t_{hold} 取决于 C_{load}

⁴⁾ Data上的负载： $C_{load}=100pF$ ， $R_{load}=100k\Omega$

3.4 数字接口时序规格

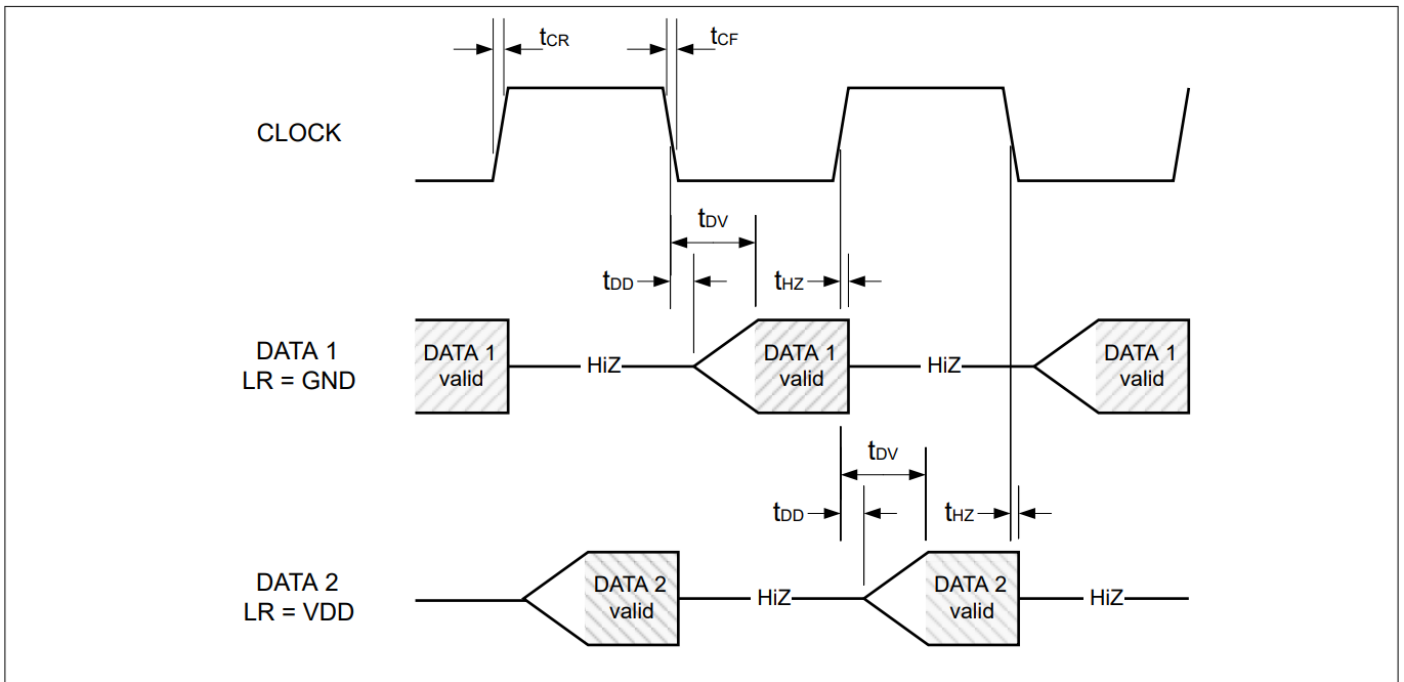


图 9 IM69D127V11 时序图

3.5 PDM 通道配置

表 7 使用L/R引脚的PDM通道配置

Channel	Data driven	Data high-Z	L/R connection
DATA1	Falling clock edge	Rising clock edge	GND
DATA2	Rising clock edge	Falling clock edge	V _{DD}

3.6 音频DC偏置

数据流中的 DC 输出电平由启动时 L/R 的状态决定。在每种情况下 DC 输出电平随时间保持稳定，并不会随输入信号电平而变化。

表 8 使用 L/R 引脚的DC输出水平

LR state	DC output level (typical)	Unit
LR = GND	-80	dBFS
LR = VDD	-40	dBFS

电气参数及特性

3.7 立体声 PDM 操作

IM69D127V11 可用在 PDM 总线上的一个或两个麦克风的电路中。当连接两个麦克风时，可根据每个麦克风的L/R引脚状态交替传输数据。当连接到同一 PDM 总线时，两个麦克风的电源模式是相同的，因为它们都由相同的 PDM 时钟控制。与每条总线单个麦克风的配置相比，立体声PDM配置下的性能是没有变化的。

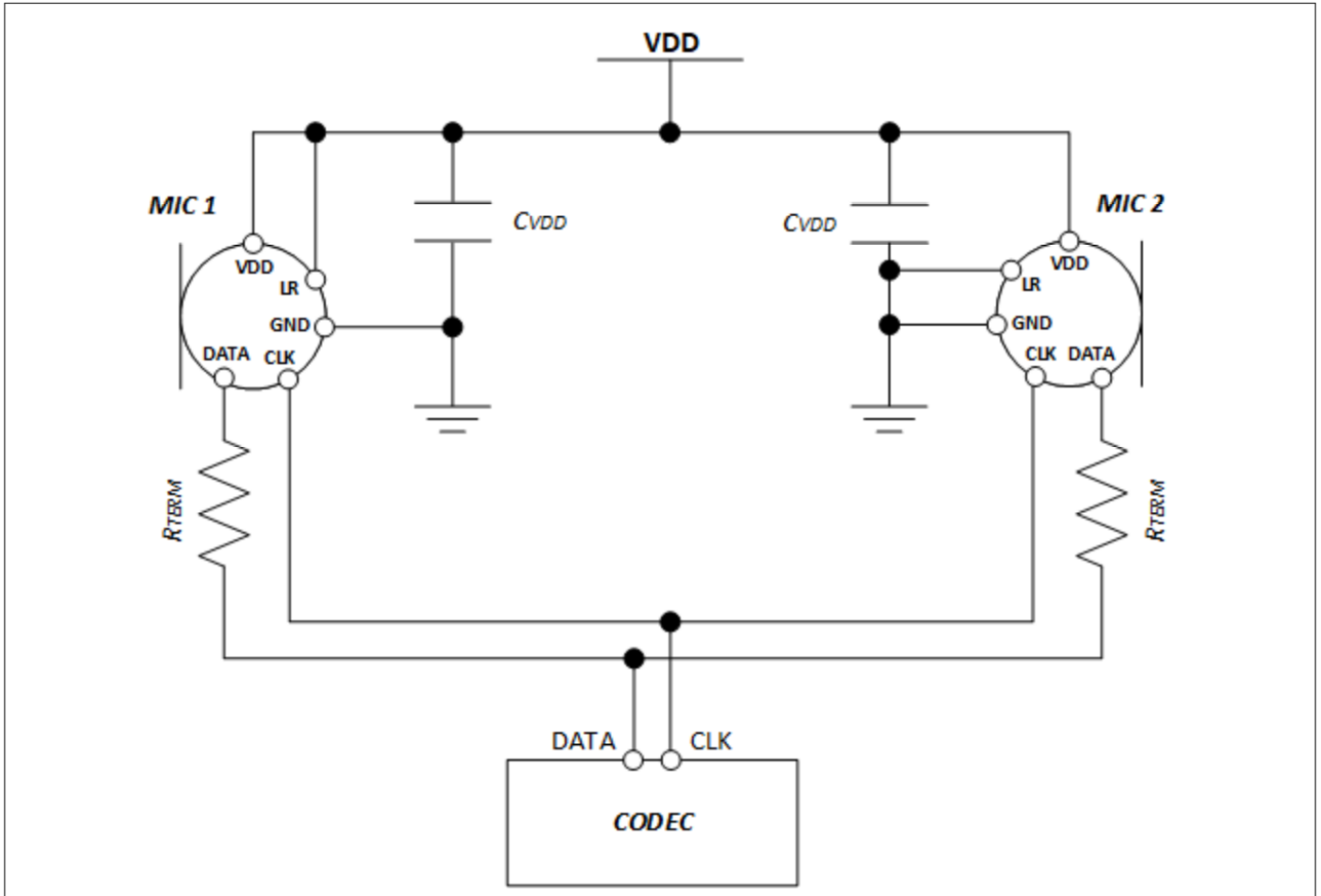


图10 IM69D127V11 立体声模式配置

注：为获得最佳性能，强烈建议在VDD 和地之间放置一个100nF ($C_{VDD_typical}$) 的电容。该电容应尽可能靠近V_{DD}。可以添加一个约100Ω 的终端电阻(R_{TERM})，以减少输出信号上的振铃和过冲。

封装信息

4 封装信息

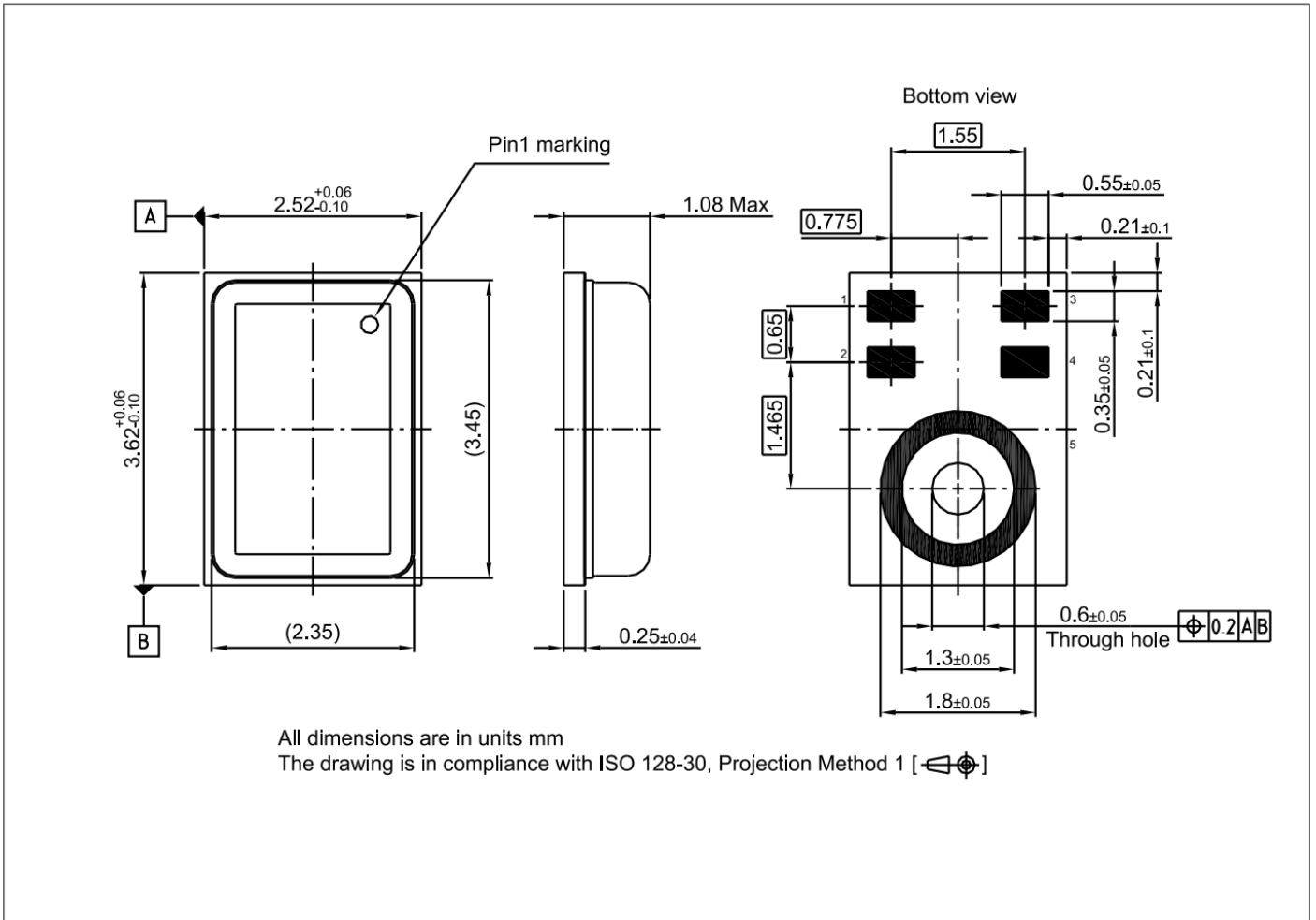


图 11 IM69D127V11封装图。

表 9 IM69D127V11 引脚配置

Pin Number	Name	Description
1	DATA	PDM data output
2	V _{DD}	Power supply
3	CLOCK	PDM clock input
4	SELECT	PDM left/right select
5	Ground	Ground

包装信息

6 包装信息

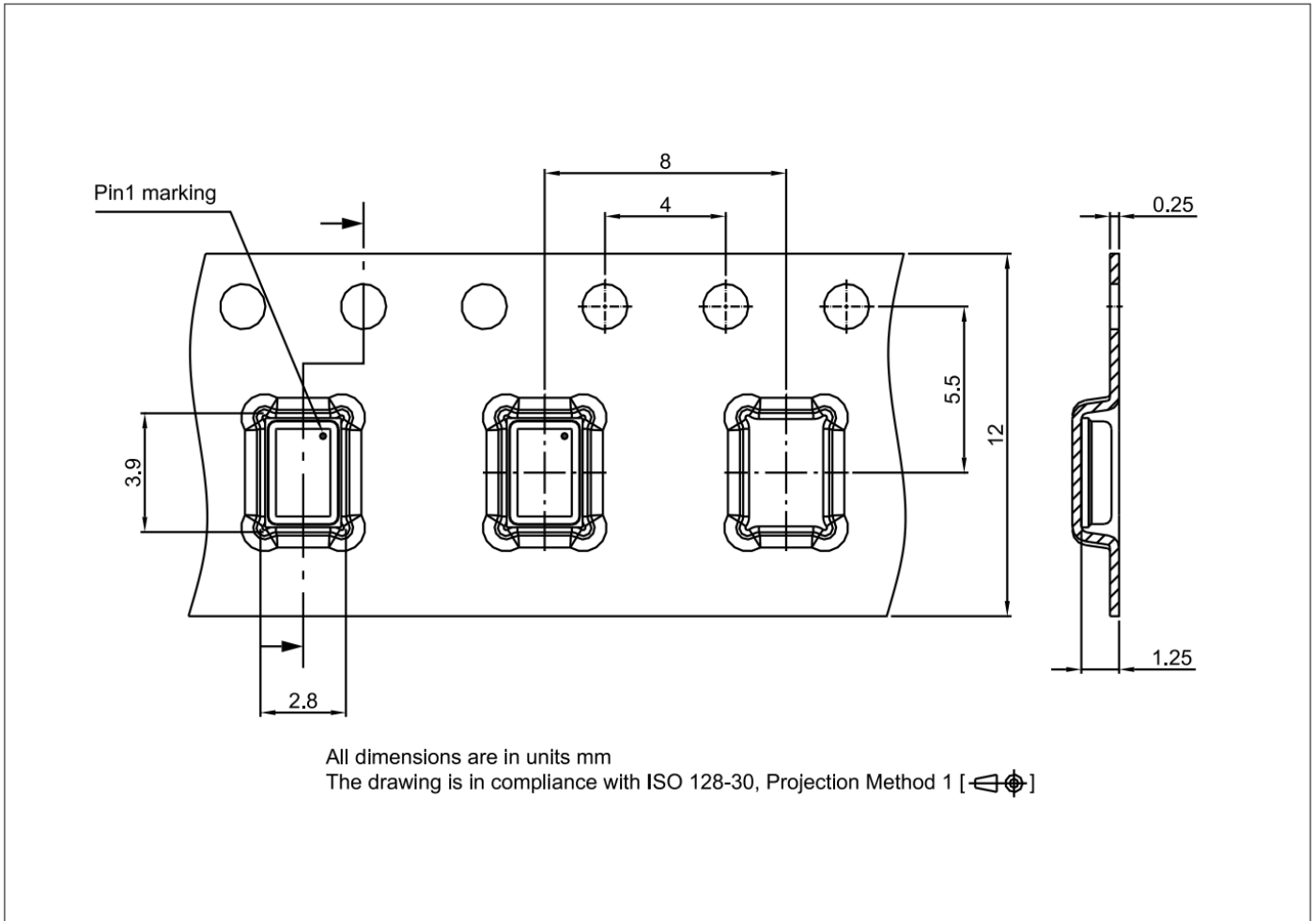


图 13 IM69D127V11 包装信息

表 10 IM69D127V11 包装信息

Product	Type code	Reel diameter	Quantity per reel
IM69D127V11	I69D10	330 mm	5000

7 回流焊和电路板组装

英飞凌 MEMS 麦克风符合 IPC/JEDEC J-STD-020D-01 标准。MEMS 麦克风的湿度灵敏度等级为 MSL1。建议使用回流焊来进行 MEMS 麦克风的 PCB 组装。

为达到最优的焊接质量，回流温度曲线应与锡膏制造商的建议一致。推荐用图 14 所示的回流温度曲线来生产包含英飞凌 MEMS 麦克风的电路板。

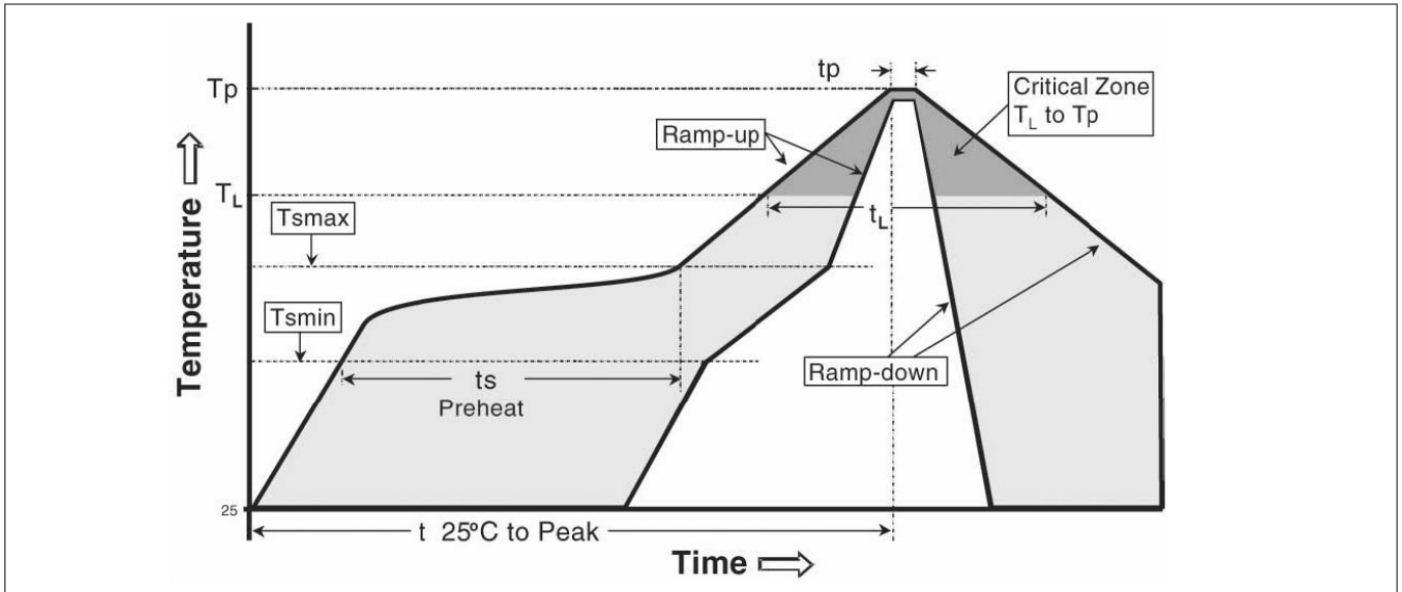


图 14 推荐的回流焊温度曲线

表 11 回流焊温度曲线限制

Profile feature	Pb-Free assembly	Sn-Pb Eutectic assembly
Temperature Min (T_{smin})	150 °C	100 °C
Temperature Max (T_{smax})	200 °C	150 °C
Time (T_{smin} to T_{smax}) (t_s)	60-120 seconds	60-120 seconds
Ramp-up rate (T_L to T_p)	3 °C/second max.	3 °C/second max.
Liquidous temperature (T_L)	217 °C	183 °C
Time (t_L) maintained above T_L	60-150 seconds	60-150 seconds
Peak Temperature (T_p)	260°C +0°C/-5°C	235°C +0°C/-5°C
Time within 5°C of actual peak temperature (t_p) ⁵⁾	20-40 seconds	10-30 seconds
Ramp-down rate	6 °C/second max.	6 °C/second max.
Time 25°C to peak temperature	8 minutes max.	6 minutes max.

注：更多信息请参阅英飞凌科技网页上的“英飞凌封装组装的一般建议”文档

⁵⁾ 峰值温度 (T_p) 的公差定义为供应商的最小值和用户的最大值

回流焊和电路板组装

MEMS 麦克风可以使用行业标准的取放设备。应注意避免损坏麦克风结构，如下所示：

- 请勿使用接触麦克风声孔的真空工具拾取麦克风。
- 麦克风声孔不应暴露在真空中，否则可能会破坏 MEMS。
- 请勿将空气吹入麦克风声孔。如果采用吹气清洁工艺，则必须将声孔密封以防止颗粒物污染。
- 推荐在无尘室环境中进行 PCB 组装，以避免麦克风受到污染。
- 不应将吹气和超声波清洁工艺应用于 MEMS 麦克风。建议在组装时使用免清洗锡膏，以避免后续的清洁步骤。清洁物质可能会严重损坏麦克风的 MEMS。
- 为防止 PCB 组装时声孔被堵塞或部分堵塞，建议在 PCB 切割或系统组装时用保护胶带覆盖声孔。
- 将麦克风放置在 PCB 上时请勿用力过猛。建议使用行业标准的拾取和放置工具，以限制施加在封装上的机械力。

可靠性规格

8 可靠性规格

测试后的麦克风灵敏度和SNR与初始值的偏差不得超过 3dB。所有样品在受力前都要经过 3 次回流焊（峰值温度为 260°C）。

表 12 可靠性测试

Test	Test Condition	Standard
Low temperature operation	T _a = -40°C, VDD = 2.5V, 1000 hours.	JESD22-A108
Low temperature storage	T _a = -40°C, 1000 hours.	JESD22-A119
High temperature operation	T _a = +125°C, VDD = 2.5V, 1000 hours.	JESD22-A108
High temperature storage	T _a = +125°C, 1000 hours.	JESD22-A103
Temperature cycling	1000 cycles, -40°C to +125°C, 30 minutes per cycle.	JESD22-A104
Temperature Humidity bias	T _a = +85°C, R.H = 85%, VDD = 2.5V, 1000 hours.	JESD22-A101
Vibration	20Hz to 2000Hz with a peak acceleration of 20g in X, Y, and Z for 4 minutes each, total 4 cycles.	IEC 60068-2-6 / MIL-STD 883K 2007.3
Mechanical shock	10000g/0.1 msec in X, Y, Z direction. 5 shocks in each direction, 30 shocks in total. VDD = 2.0V	IEC 60068-2-27
Reflow solder ⁶⁾	3 reflow cycles, peak temperature = +260°C	IPC-JEDEC J-STD-020D-01
ESD-SLT	25 discharges of +/-8kV direct contact to lid while unit is grounded.	IEC-61000-4-2
ESD-CDM	3 discharges of +/-500V direct contact to I/O pins.	JEDEC JS-002-2014
ESD-HBM	3 discharges of ±2kV pin to pin.	JEDEC JS-001-2011

⁶⁾ 经过3轮回流后，麦克风灵敏度与初始值的偏差不得超过1dB。

修订记录**修订记录**

Document version	Date of release	Description of changes
v01_00	2020-10-27	<ul style="list-style-type: none">Initial datasheet release
v01_10	2022-03-15	<ul style="list-style-type: none">updated Tape and Reel Information

词汇表



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

重要通知

版本 2026-02-12

Infineon Technologies AG 出版，
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2026 Infineon Technologies AG
及其关联公司。
保留所有权利。

**Do you have a question about this
document?**

Email:
erratum@infineon.com

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担不侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文档包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。